

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】令和6年10月18日(2024.10.18)

【国際公開番号】WO2023/153188
 【出願番号】特願2023-580152(P2023-580152)

【国際特許分類】

H 0 1 L 2 3 / 5 0 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 1 L 2 3 / 2 8 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 1 L 2 5 / 0 4 (2 0 2 3 . 0 1)

10

【F I】

H 0 1 L 2 3 / 5 0 K

H 0 1 L 2 3 / 5 0 R

H 0 1 L 2 3 / 2 8 J

H 0 1 L 2 5 / 0 4 Z

【手続補正書】

【提出日】令和6年6月14日(2024.6.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

20

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1半導体素子と、

前記第1半導体素子に導通する第1端子と、

前記第1半導体素子に導通するとともに、第1方向において前記第1端子から離れて位置する第2端子と、

前記第1端子および前記第2端子の各々の一部と、前記第1半導体素子と、覆う封止樹脂と、を備え、

30

前記封止樹脂は、前記第1方向に対して直交する第2方向を向き、かつ前記第2方向において前記第1端子および前記第2端子から最も近くに位置する第1側面を有し、

前記第1端子および前記第2端子は、前記第1側面から離れて位置する、半導体装置。

【請求項2】

前記第1半導体素子が搭載されたダイパッドをさらに備え、

前記第1方向および前記第2方向に対して直交する第3方向に視て、前記ダイパッドは、前記第1方向に延び、かつ前記第2方向において前記第1側面から最も近くに位置する第1縁を有し、

前記第1端子および前記第2端子は、前記第1縁の前記第1方向の両側に位置する、請求項1に記載の半導体装置。

40

【請求項3】

前記第1端子および前記第2端子は、前記第2方向において前記第1縁を基準として前記第1側面とは反対側に位置する、請求項2に記載の半導体装置。

【請求項4】

前記第3方向に視て、前記第1端子は、前記第1縁の一端から前記第1方向に延びる第1延長線に重なる、請求項2に記載の半導体装置。

【請求項5】

前記第3方向に視て、前記第2端子は、前記第1縁の他端から前記第1方向に延びる第2延長線に重なる、請求項4に記載の半導体装置。

50

前記第 1 方向において互いに離れて位置し、かつ前記ダイパッドを支持する 2 つの第 4 端子をさらに備え、

前記 2 つの第 4 端子の各々の一部は、前記封止樹脂に覆われており、

前記複数の第 3 端子は、前記第 1 方向において前記 2 つの第 4 端子の間に位置する、請求項 1.5 に記載の半導体装置。

10

20

30

40

50